

2026 年 3 月期 第 2 四半期 決算説明会 Q&A

■ 質問一覧

- Q1 3ヶ月前に CY2026 の見通しを修正されたが、現在の CY2026 の WFE 市場の見通しとアプリケーション別の伸び率を教えてください。
- Q2 CY2026 の WFE 市場の成長について、中国の WFE 投資の状況を加味した見通しを教えてください。また、中国への新たな輸出規制について懸念はあるか？
- Q3 将来的に TEL の総売上高に占める中国売上高の比率が 20%程度に戻る可能性はあるか？
- Q4 決算説明会資料の 14 ページについて。ボンダーレーザ関連装置の売上は 2030 年までに 5 年間で累計 5,000 億円以上を見込むということはいずれ単年度で 1,000 億円以上の売上に到達することになる。成長を牽引するのは何か？
- Q5 決算説明会資料の 14 ページについて。AI・HPC 向けプロバの売上を CY2025～2030 の 5 年間で CAGR15%以上伸ばしていくということだが、こちらは市場成長と TEL のシェアの向上のどちらで実現されるのか？
- Q6 フィールドソリューション売上について、FY2026 Q2 は、1,600 億円を超えている。これは生産能力増強投資より技術転換投資が大きいから一時的に増えているのか。今後 WFE 市場が拡大すれば減少するのか。あるいは、この 1,600 億円が今後のフィールドソリューション売上の新たな水準となるのか？
- Q7 今回発表された FY2026 通期のガイダンスの利益率は、7 月 31 日に下方修正をした際の水準から大きく変わっていない。業績が下降局面になったことで、コストコントロールを見直す良い機会になると期待していたが、大きなコスト削減を実行するのは難しいのか？
- Q8 半導体の市況がかなり改善してきているなかで、FY2027 が最終年度となる中期経営計画の 3 兆円という売上高目標の達成可能性についてどのように考えているか？

■ Q&A

Q1 3ヶ月前に CY2026 の見通しを修正されたが、現在の CY2026 の WFE*¹ 市場の見通しとアプリケーション別の伸び率を教えてください。

A1 現在精査中だが、過去最高になるだろうと見ている。AI サーバー向けの先端需要が非常に強く、特に DRAM は 2 桁成長する見込み。顧客の生産計画を注視していくが、ファブの空きスペースが整う CY2026 後半から投資が加速するとみている。NAND はデータセンターのニアラインストレージ向けに需要が上がっているが、NAND 消費の多い PC・スマートフォンの需要は軟調であり、需要が上がってきたら生産能力増強の投資につながるが、今のところまだそのサインが見えていない。ただし、メモリの需要の成長ポテンシャルは高い。PC・スマートフォンの需要が回復すると、DRAM・NAND ともに慢性的に需給がひっ迫し、ロングタームのスーパーサイクルに入る可能性もある。
非メモリに関しては、成熟世代向け投資はほぼ横ばいを維持し、AI サーバーを中心とした先端ロジック/ファウンドリ向け投資は増加するとみている。

[▲Top](#)

Q2 CY2026 の WFE 市場の成長について、中国の WFE 投資の状況を加味した見通しを教えてください。また、中国への新たな輸出規制について懸念はあるか？

A2 中国以外の WFE 投資については高い期待感を持っている。中国においても、汎用デバイス向けを中心に、一定規模の投資は継続すると考えているが、それ以上の投資を示唆するような情報は現時点では把握していない。現時点においては、当社の業績に影響する追加規制は発生していない。今後も、日本政府の方針に従い、適切に対応していく。

[▲Top](#)

Q3 将来的に TEL の総売上高に占める中国売上高の比率が 20%程度に戻る可能性はあるか？

A3 今後、付加価値の高い先端半導体向けの売上が増加することにより、相対的に中国売上比率は減少し、将来的には 30%以下の水準になることも想定している。

[▲Top](#)

Q4 決算説明会資料の 14 ページについて。ボンダールレーザ関連装置の売上は 2030 年までの 5 年間で累計 5,000 億円以上を見込むということは、いずれ単年度で 1,000 億円以上の売上に到達することになる。成長を牽引するのは何か？

A4 最先端ロジック、DRAM、NAND のすべてのアプリケーションにおいて引き合いは非常に強い。今後の当社の急激な売上拡大を牽引する要素は、①採用されるアプリケーションの拡大、②当該市場の成長、③TEL のシェア獲得の 3 つが挙げられる。

[▲Top](#)

Q5 決算説明会資料の 14 ページについて。AI・HPC 向けプローバの売上を CY2025～2030 に CAGR15% 以上伸ばしていくということだが、こちらは市場成長と TEL のシェアの向上のどちらで実現するのか？

A5 当社は先端ロジック向けのプローバにおいて、非常に高いシェアを有している。その中でも特に AI・HPC 向けプローバは、テスト回数・時間が徐々に増加している。それに加え、ダイプローバのような新たなテスト手法の導入も見込まれている。そのため AI サーバー需要の拡大とともに、CAGR15%以上の売上の成長が期待できる。

[▲Top](#)

Q6 フィールドソリューション売上について、FY2026 Q2 は、1,600 億円を超えている。これは生産能力増強投資より技術転換投資が大きいから一時的に増えているのか。今後 WFE 市場が拡大すれば減少するのか。あるいは、この 1,600 億円が今後のフィールドソリューション売上の新たな水準となるのか？

A6 顧客の工場稼働率が上がれば、パーツ・サービスを中心にフィールドソリューション売上が伸びる。顧客の歩留まりを上げていけるようなサービス・技術を提供できることは非常に重要である。また、顧客の装置をアップグレードする改造の需要も大きい。インストールベースの増加とともに、フィールドソリューションの事業機会は増加していく。

[▲Top](#)

Q7 今回発表された FY2026 通期のガイダンスの利益率は、7 月 31 日に下方修正をした際の水準から大きく変わっていない。業績が下降局面になったことで、コストコントロールを見直す良い機会になると期待していたが、大きなコスト削減を実行するのは難しいのか？

A7 CY2030 に 1 兆ドルとも想定される半導体市場の将来的な拡大を踏まえて、短期はもとより、中長期的な成長を確実に考えていきたい。2024 年 2 月に発表した成長投資の戦略によって、大きな成長に向けた準備ができてきた。これらのアセットを最大限活用し、顧客からの要請に対応していきたい。短期的には業績連動報酬による下方柔軟性のある程度備えている他、AI とロボティクスを用いたデジタルトランスフォーメーションを推進することによる効率性向上も目指し、ダイナミック・ケイパビリティをしっかりと確保しながら、ワールドクラスの利益率を追求する。

[▲Top](#)

Q8 半導体の市況がかなり改善してきているなかで、FY2027 が最終年度となる中期経営計画の 3 兆円という売上高目標の達成可能性についてどのように考えているか？

A8 中期経営計画を発表して以降、付加価値の高い、最先端向けの装置を創出し、稼ぐ力を着実につけてきた。今後も最先端エリアに対する当社の技術提供の機会が増えていく。足元で半導体市場はマクロ経済、地政学的な影響を受けているものの、それをオフセットする AI サーバーの需要も生まれている。WFE が想定規模に達すれば、中期経営計画の目標値にも近づけると考えている。諸般の要因を注視しつつ、可能性を追っていきたい。

[▲Top](#)

*1 WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

FY2026 は 2025 年 4 月～2026 年 3 月の会計年度を指しています。

FY2027 は 2026 年 4 月～2027 年 3 月の会計年度を指しています。

本内容は質疑応答のサマリーです。スライドに同期した音声配信は[こちら](#)から。